

日月光一〇六年度第四季業績簡訊

日月光半導體於台灣時間 107 年 2 月 1 日同步於美國及台灣兩地發佈一〇六年度第四季獲利報告，本公司一〇六年第四季之合併營業收入較一〇六年第三季成長 14%，較一〇五年同期成長 9%，為新台幣 83,986 百萬元。茲將日月光一〇六年度第四季單季之合併營運成果、產品結構及其銷售地區比重表列如下：

合併綜合損益表（單位：新台幣百萬元）

項 目	106 年度 第四季	106 年度 第三季	105 年度 第四季	106 年度 全年度	105 年度 全年度
營業收入淨額	83,986	73,878	77,128	290,441	274,884
營業毛利	14,793	13,848	15,374	52,732	53,187
營業淨利（淨損）	7,706	7,068	8,130	25,218	26,660
稅前淨利（淨損）	7,879	7,815	9,660	30,929	27,984
所得稅利益（費用）	(1,085)	(1,083)	(1,274)	(6,261)	(5,091)
非控制權益	(548)	(396)	(429)	(1,680)	(1,250)
歸屬予本公司業主之淨利（淨損）	6,246	6,336	7,957	22,988	21,643
基本每股盈餘(新台幣元)	0.74	0.76	1.04	2.82	2.82
稀釋每股盈餘(新台幣元)	0.71	0.69	0.88	2.62	2.37

綜合損益表 - 半導體封裝測試（單位：新台幣百萬元）

項 目	106 年度 第四季	106 年度 第三季	105 年度 第四季	106 年度 全年度	105 年度 全年度
營業收入淨額	41,794	41,854	43,463	161,081	160,516
營業毛利	10,862	10,486	11,645	39,208	40,002
營業淨利（淨損）	6,001	5,724	6,373	19,810	20,700
稅前淨利（淨損）	7,099	7,205	9,038	26,973	25,424
所得稅利益（費用）	(776)	(784)	(967)	(3,671)	(3,481)
非控制權益	(77)	(85)	(114)	(314)	(300)
歸屬予本公司業主之淨利（淨損）	6,246	6,336	7,957	22,988	21,643

半導體封裝測試銷售分析

產品應用別佔比	%
通訊	48
電腦	11
汽車, 消費性電子及其它	41
前十大客戶佔營收比重	49

測試業務產品組合	%
後段測試	78
晶圓測試	19
前段測試	3
測試資本支出金額	28 百萬美元
測試機台數	3,760 台

封裝業務產品組合	%
Bumping, Flip Chip, WLP & SiP	34
IC Wirebonding	55
Discrete and Others	11
封裝資本支出金額	103 百萬美元
打線機台數	16,076 台

電子代工服務銷售分析

產品應用別佔比	%
通訊	42
電腦	14
消費性電子	32
工業用	6
汽車電子	5
其它	1
前十大客戶佔營收比重	90
EMS 資本支出金額	7 百萬美元

根據對當前業務狀況的評估及匯率的假設，日月光公司 2018 年第一季的業績展望如下：

- 以美元計價之半導體封測事業第一季生意量將略高於去年第一季水準；
- 排除匯率影響，半導體封測事業第一季毛利率將略高於去年第一季水準；
- 電子代工服務第一季生意量將略低於去年第三季水準；
- 電子代工服務第一季毛利率將略高於去年第四季水準。